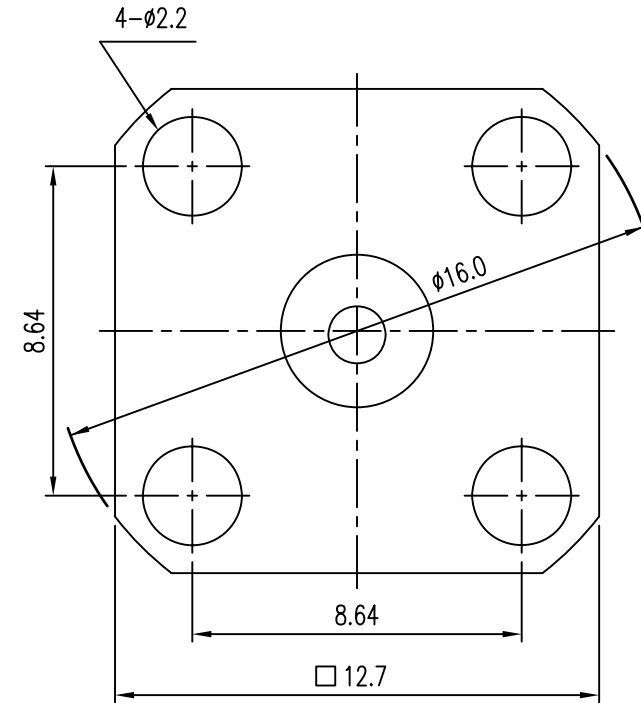
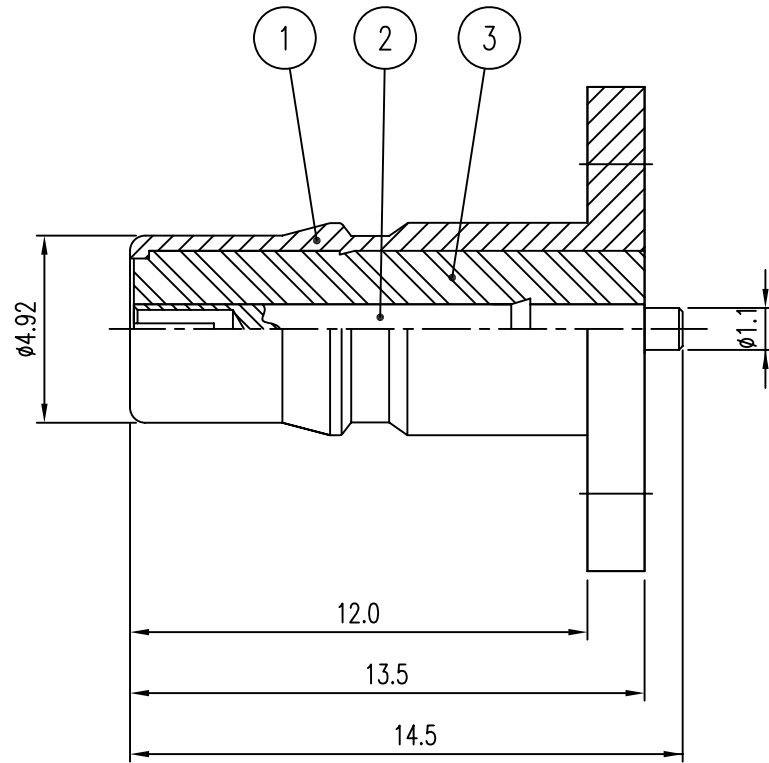


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
1	(참변No.201504-0006) BODY 표준화 치수 변경 및 PIN, TEFLON 치수 변경	H.J.LEE	I.C.KIM	2015. 04. 16.					
2	(설변No.201806-0002) QMA 표준화 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018. 06. 11.					



1 1 21	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00894-N/2	
	2	CONTACT	1	BeCu	SUCO Plate	DCT00943-5/2	
	1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate	DBD01214-5/2	
대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 소수 각도 분수 _____		년월일 2018. 06. 11.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
		승인	I.C.KIM				
		검도					
재질 _____	제도			도명			
열처리 _____	S.Y.EUN			KQMA50 SOLDER END JS-4H			
보호파막처리 _____	작성부서			A4			
	연 구 소						
	적도 5/1	단위 mm	중량	도번 CN00837-7/2			